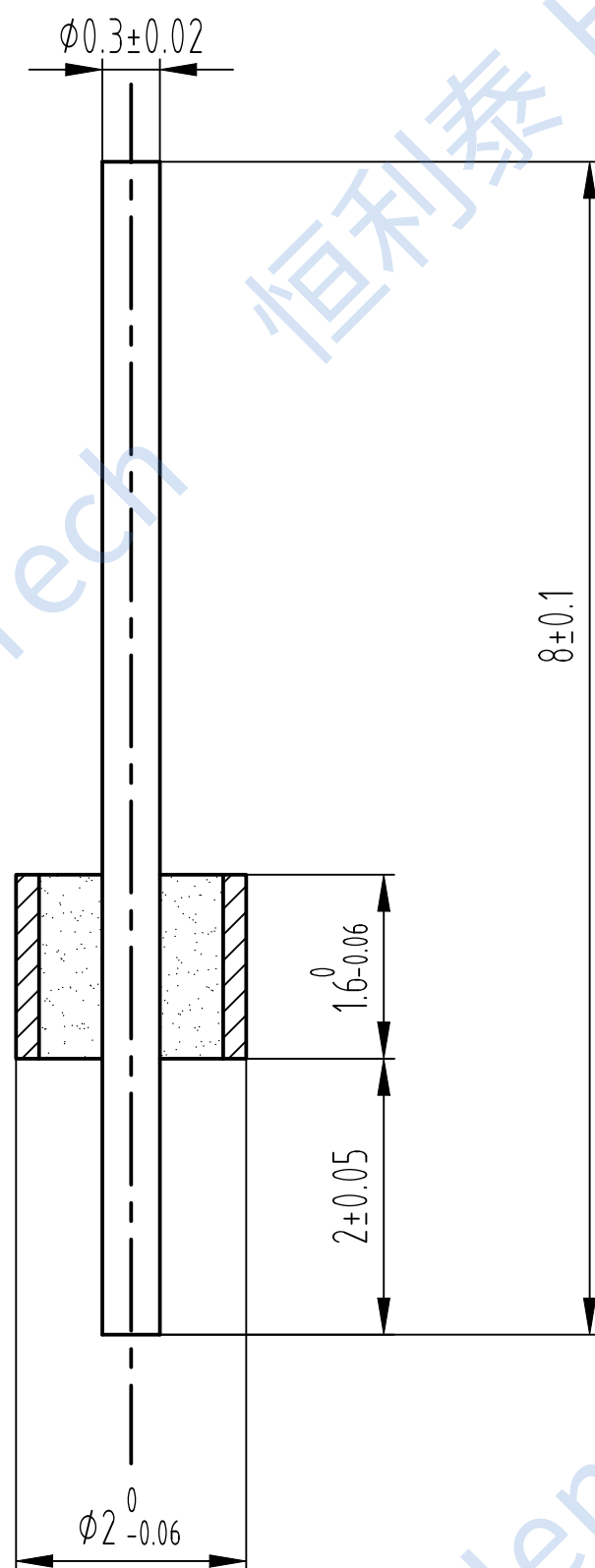




技术要求：

1. 特性阻抗 : 50Ω
2. 频率范围 : DC~46.5GHz
3. 驻波比 : ≤ 1.3
4. 插入损耗 : $\leq 0.2\text{dB}$
5. 绝缘电阻 : $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
6. 介电耐压 : $\geq 300\text{V}$
7. 使用寿命 : ≥ 500 次
8. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围 : $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$
10. 镀层厚度 : $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记	技术要求： 1. 特性阻抗：50Ω 2. 频率范围：DC~46.5GHz 3. 驻波比：≤1.3 4. 插入损耗：≤0.2dB 5. 绝缘电阻：≥5000MHz@500V 6. 介电耐压：≥300V 7. 使用寿命：≥500次 8. 密封漏率：≤1.013x10⁻³Pa·cm³/S 9. 温度范围：-65℃~+155℃ 10. 镀层厚度：≥0.5μm软金									
描 图										
校 描										
旧底图总号										
						装 配 图			HN-RF2016-0.3(8-2)M	
签 字										
	标记	处数	更改文件号	签 字	日期				成都恒利泰科技有限公司	
日 期	设计	M。	标准化			图 样 标 记		重 量	比 例	
	审核								11:1	
	工艺		日期			共 页		第 页		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd